

熱管之原理、製作與應用

王啟川、簡國祥

Tel:03-5916294 Email: ccwang@itri.org.tw

空調機研究室 熱流技術組 能源與資源研究所



- 1. 基本原理介紹
- 2. 熱管的製作
- 3. 熱管類產品的應用



熱管的組成主要有三項基本要素

- 密閉容器(container)
- 毛細管構造(wick)
- 工作流體(working fluid)







管



▶較大的傳熱能力

- ▶較高的等溫性
- ▶熱響應迅速
- ▶具有熱流密度變換功能
- ▶重量輕
- ▶無可動件







材質	熱傳導係數	
熱 管	50,000 - 200,000 W/m °C	
鋁	180 W/m °C	
銅	380 W/m °C	
鑽石 2,000 W/m ℃		











- 沒有運動部件,每根熱管都是永久性密封的,沒有額外的能量消耗,可大大提升操作的可靠性。
- 熱管熱交換器的結構可使用逆流設計,而且熱管本身的溫降很小, 近乎等溫運作,故熱交換效率高。
- 由於冷、熱流體都在熱管外表面流過,所以容易用增加鰭片的方法 來提高冷、熱流體與熱管表面的對流熱傳性能。
- 每根熱管完全獨立,容易更換,管排寬度及熱管外表面鰭片高度和 間距可以根據性能要求及維修、清洗的要求,進行適當的選擇。
- 設備的傳熱性能為可逆安排設計,即冷、熱流體可以變換,這對空調系統的節能十分有利。
- 結構比較緊湊密集,單位體積的傳熱面積大,通常在流動方向上熱 交換器的尺寸不大於500 mm。
- 即使於冷、熱氣流間溫差很小(如僅十幾度)的情況,也能得到一定的熱回收效率。
- 溫度低於露點,熱管熱交換器仍可以適用,例如用於溶劑的回收。
 壽命長。



熱管工作流體的特性

• 熱傳性能好

- 與管蕊、管殼材料能長期相容
- 化學組成穩定
- 適中的飽和蒸氣壓
- 熱傳導係數高
- 潤濕性能好





工業技術研究院 _{能源與資源研究所}

Industrial Technology Research Institute

Energy & Resources Laboratories

工作流體與適用溫度範圍



工業技術研究院 能源與資源研究所

Industrial Technology Research Institute Energy & Resources Laboratories 熱管工作流體與材料不相容的原因與影響

影響	原因	
熱管熱阻增	 1.反應產物沉積,使熱傳係數減小 2.由於化學反應產生不凝結氣體 3.管殼、管蕊、工作流體的出氣 4.工作流體分解產生不凝結氣體 	
熱管傳熱能 下降	 1. 管蕊被固體顆粒堵住,流動阻力增大 2. 管蕊內有氣泡存在,使流動阻力增加或使液流中 3. 由於化學反應使管蕊潤濕能力下降 4. 由於工作流體中溶解了反應產物或金屬離子,使 變小 5. 工作流體中溶解了反應物使粘度增加 6. 管蕊被腐蝕,無法輸送液體 	斷 表面張力
管殼損壞	 1. 管殼的電化學腐蝕 2. 管殼材料溶解在工作流體中 	





管殼
工作流體
毛細結構



流體相變化傳熱









普通熱管中管蕊的樣式可分為二類,即均勻管蕊和組合管蕊。常用的均勻管蕊有 編織層網、軸向糟道、燒結蕊等;這類管蕊大多具有結構簡單的特點,但性能稍 差。組合管蕊的結構較複雜,但具有較好的傳熱性能與較小的熱阻









SINTERED METAL FIBERS



SINTERED METAL POWDER



GROOVES IN HEAT PIPE WALL



SLOTTED METAL SHEET



熱管內壓力變化

較低氣體速度下,熱管內的氣液的壓力分布









較高氣體速度下,熱管內的氣液的壓力分布







工作流體	相容材料	不相容材料
水	不鏽鋼、銅、鎳、鈦	<u>鋁</u>
阿摩尼亞	鋁、不銹鋼、鐵、鎳	銅
丙酮	鋁、不銹鋼、銅	
甲醇	不銹鋼、鐵、銅、鎳	鋁
冷媒	鋁	

Source: A. Faghri



壓力損失與平衡

$$\Delta P_{cap,\max} \geq \Delta P_l + \Delta P_v \pm \Delta P_g$$

 ΔP_I :液相壓損 ΔP_v :汽相壓損 ΔP_g :重力壓損

$$\Delta P_{cap,\max} = \frac{2\sigma\cos\theta}{r_p}$$

σ:表面張力
 θ:接觸角
 r_p:毛細孔半徑









Source: Faghri



液汽介面



$$\Delta P_{cap,\max} = \frac{2\sigma}{r_p}$$



壓力

細



蒸發區





$$\Delta P_{cap,\max} \geq \Delta P_l + \Delta P_v + \Delta P_g$$

Darcy's Law

$$\Delta P_l = \frac{\mu_l m_l L_{eff}}{\rho_l K A_w}$$

$$Q = m_l \times h_{fg}$$

管壓力損失

L_{eff}: 熱管有效長度=[L_a+(L_e+L_c)/2]

熱



K:多孔性物質的滲透係數 (和孔隙度、孔隙分佈與孔隙幾何尺寸有關)

Aw:液體流通截面積





□銅粉燒結

$$K = \frac{r_s^2 \times \varphi^3}{37.5(1-\varphi)^2}$$

 φ : 孔隙度 r_s : 平均粉粒半徑

注意:同時對於毛細半徑之影響





對於液體流動,滲透度是一種毛細阻力的基準,此值越大代表流動阻力愈小,流體在毛細結構裡的流動性愈好,反之,則流動阻力上升。





$$\Delta P_{cap,\max} \geq \Delta P_l + \Delta P_v + \Delta P_g$$

$$\Rightarrow \Delta P_{v} = \frac{8\mu_{v}QL_{eff}}{\pi\rho_{v}R_{v}^{4}h_{fg}}$$

管壓力損失

$$\Rightarrow \quad \Delta P_g = \rho_l g L \sin \phi$$

熱管設計的限制

- 蒸氣壓限制:在熱管內的蒸氣壓通常不高,而沿著冷凝段方向由於摩差的損耗,蒸 氣壓會逐步下降,然而氣體與液體不同,液體藉由表面張力的影響可以忍受負壓(即 拉力),但氣體的壓力不可能有負壓的情況,因此即使在冷凝段的盡頭,蒸氣的壓力 必定是大於零。
- 音速限制:在低溫與低壓的應用場所中,氣體的相對密度較低而流速也比較高,如果氣體的速度高到等於該位置的音速時,我們稱之此時達到聲速限制,此時並稱之為choked,也就是說無法再增加流速或流量,同樣的音速限制與蒸發段進口的溫度有關。
- 攜帶限制:熱管內氣體與液體的相對流速通常甚快,此一氣體流動的慣性力可能將 管蕊上的液體剝離,因此這些脫離管蕊的液體便會造成氣體流向冷凝段的障礙,如 果此一濺灑的情持續惡化,將會促使蒸發段出現乾涸的現象(dry Out),此時稱之為攜 帶限制。
- 循環限制:熱管中的驅動壓力差與管蕊及工作流體有很大的關聯,一旦建立最大毛 細壓力,則熱管內的流率將會維持在一個固定值以下,若持續的增加熱傳量將可能 使蒸發段出現乾涸的現象,此時的熱通量稱之為循環限制。
- 沸騰限制:通常在蒸發段內,液體是以蒸發的型態變化成氣體,但是如果熱通量過大,則液體有可能以沸騰的形式轉變成氣體,如果沸騰相當的激烈,則可能造成蒸發段表面出現乾涸的現象,此時稱之為沸騰限制,不過因為沸騰促成的乾涸的現象 很難預測,因此習慣上多以蒸發段出現沸騰現象時稱之,沸騰限制對毛細驅動的影響較大,以重力驅動的熱虹吸型熱管,沸騰並不會立即帶來乾涸的嚴重後果(這是因為熱虹吸型熱管所填充的工作流體通常比較多)。





銅水熱管所遇之極限













池沸腾曲

線



熱管的毛細限

□毛細限

對於均勻加熱與冷卻之熱管

$$(QL)_{cap,\max} \leq \frac{\frac{2\sigma}{r_{eff}} - \rho_l gL \sin\phi}{F_l + F_v}$$

$$F_l = \frac{\mu_l}{\rho_l K A_w h_{fg}}$$

$$F_{v} = \frac{(f \operatorname{Re})\mu_{v}}{2R_{v}^{2}\rho_{v}A_{v}h_{fg}}$$

液相摩擦係數

汽相摩擦係數



熱管的毛細限

對於忽略汽相壓損以及水平擺置之熱管

$$Q_{\max} = 2 \times \left(\frac{\rho_l \cdot h_{fg} \cdot \sigma}{\mu_l}\right) \times \left(\frac{K}{r_{eff}}\right) \times \left(\frac{A_w}{L_{eff}}\right)$$

Figure of Merit (工作流體性質)

毛細結構: 熱管幾何尺寸:
>滲透度要大
>毛細半徑要小
≫長度要短







$$Q_b = \frac{2\pi L_e k_{eff} \Delta T_{crit}}{\ln\left(\frac{R_i}{R_v}\right)}$$

$$\Delta T_{crit} = \frac{2\sigma T_{v}}{h_{fg}\rho_{v}} \left(\frac{1}{R_{b}} - \frac{1}{R_{men}}\right)$$

$$R_b = \sqrt{\frac{2\sigma T_{sat}k_l(v_v - v_l)}{h_{fg}q_r}}$$

K_{eff}: 毛細結構等效熱傳導係數 R_i: 管內半徑

qr:徑向熱通量



降低蒸汽泡半徑R_b ⇒ 提昇沸騰極限

- 1. 加熱表面與工作流體具有好的潤濕性。
- 2. 管壁與毛細結構具有好的熱接觸。
- 3. 工作流體要純化與去溶解氣體。
- 4. 平整之加熱面,以及使用高熱傳導性能之材料。

提昇熱管沸騰限

5. 毛細結構與容器必須乾淨。











$R_{hp} = R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8$

阻

管的熱

	熱阻	大 小(℃/W) -	🕶 數值大小依實際而定
R ₂	$ln(D_o/D_i)/2\pi L_e K_{wall}$	10 ⁻³	
R ₃	$\ln(D_i/D_v)/2\pi L_e K_{wick,eff}$	10 ⁻² ~10 ⁻¹	
R ₄	$RT_v^2 (2\pi RT_v)^{1/2} / h_{fg}^2 P_v A_e$	10 ⁻⁷	D ₀ :外徑
R ₅	$\frac{128 \mu_{\rm v} L_{\rm eff} T_{\rm v} P_{\rm v} / \pi \rho_{\rm v}^{-2} D_{\rm v}^{-4} h_{\rm fg}}{2}$	10 ⁻¹⁰	D.:蒸汽通道
R ₆	$RT_v^2 (2\pi RT_v)^{1/2} / h_{fg}^2 P_v A_c$	10 ⁻⁷	L _e :蒸發段長度
R ₇	$ln(D_o/D_i)/2\pi L_c K_{wick,eff}$	10 ⁻² ~10 ⁻¹	L _c :冷凝段長度
R ₈	$ln(D_o/D_i)/2\pi L_c K_{wall}$	10 ⁻³	

熱



毛細結構之熱傳導係數

金屬粉燒結之毛細結構

$$k_{eff} = k_s \left(\frac{2 + \frac{k_l}{k_s} - 2\varphi \left(1 - \frac{k_l}{k_s}\right)}{2 + \frac{k_l}{k_s} + \varphi \left(1 - \frac{k_l}{k_s}\right)} \right)$$

k₁:液體導熱係數
 k_s:管殼導熱係數
 φ:孔隙度

φ增加, k_{eff}變小



毛細結構的參數

毛細結構重要參數

- ▶ 有效毛細半徑
- ▶ 孔隙度
- > 等效熱傳導係數
- ▶ 滲透性




熱管特性	金屬網	粉末燒結	溝槽
毛細力	高	高	低
滲透性	低-中	低-中	中-高
熱阻	中-高	中	低
毛細限(水平時)	中	中	高
重力對毛細限之影響	中-高	低	高
沸騰限	中	高	中
可靠度	低-中	高	高

◆此表僅是表示一般之比較,而非絕對之結果。





□熱管性能: ▲ △T → (真空度、毛細結構、管壁材質) Q_{max} → (工作流體、毛細結構、清潔度)

□任何壓損的增加均會造成熱管性能的下降

▶折彎 →(毛細結構)

▶ 打扁 → (毛細結構、蒸汽空間)

▶ 角度







> 純水機 ▶ 超音波清洗槽 ▶ 焊接機 ▶ 縮管機 ▶ 氦氣測漏儀 ▶ 燒結爐 ▶ 充填機 ▶ 真空系統 ▶ 性能測試系統 \rightarrow • • • • • •

實際設備將依產品的不同	
有所差異,所列僅做為參考。	













Vapor Chamber



Thermal Column







Actual heat transfer rate from the fin Ideal heat transfer rate form the fin if the entire fin were at base temperature

$$\dot{Q}_{fin} = \eta_{fin} h A_{fin} (T_b - T_{air})$$

 Q_{fin}

 $Q_{fin, \max}$

 $\eta_{fin} = 0$

溫度分佈越不均匀, 鰭片效率越差。 若原始效率已經很高, 不需要加熱 管。













Source:Electronic cooling







 $R_{spreading} = \frac{\sqrt{A_b} - \sqrt{A_s}}{k\sqrt{\pi A_b A_s}} \times \frac{\lambda k A_b R_{fin-air} + \tanh(\lambda t)}{1 + \lambda k A_b R_{fin-air} \tanh(\lambda t)}$

 A_b:散熱器底部面積

 A_s:元件接觸面積

 t:散熱器底部厚度

 R:散熱器熱阻

傳導

擴散









<u>分散熱阻</u>: 銅減少17%,而平板型熱管減少93%。

降低擴散熱阻

總熱阻:

銅減少5%,而平板型熱管減少27%。



均溫性:

鋁:溫差為14.21℃, 銅:溫差為12.81℃, 平板型熱管僅為5.62℃。

100 mm × 40 mm × 2.8 mm









VAPOR CHAMBER

- 傳統的散熱機制無法滿足未來CHIP的發展
- VAPOR CHAMBER的工作原理(過去因製 作困難度高,嘗試的人很少,而且製程設備 昂貴;因此功能突破的時機延遲至今)
- VAPOR CHAMBER量產的困難度,因量產 設備需配合製程特性開發.



VAPOR CHAMBER 內部作用示意圖

Ref. Thermacore



含在毛細結構內之工作介質受熱時迅速氣化,並擴散到工件內 壁·經降溫後,凝結為液態,循連結之毛細結構回流到加熱 點·此液氣相吸熱散熱的機制,傳熱的速度及量,經實測約當 同厚度,尺寸之實心銅板的25~100倍



• 熱導管主要利用工作流體在蒸發段吸收熱量蒸 發,流向冷凝段放出熱量後凝結成液態,藉由 毛細結構所提供的毛細力流回蒸發段。常見之 毛細製程有四種:技術領先的美國及日本主要以 燒結、溝槽為主,代表公司分別為美國 Thermacore燒結及Furukawa的溝槽,另外纖 維則以Fujikura為主,台灣廠商則以網狀為 主。由於使用溝槽與網狀,熱導管將受限於散 熱功率在35W以下,且形狀固定不宜改變,至 於燒結方面,由於毛細,散熱則可達85W,但 卻有加工上的限制

現有熱導管之技術



VAPOR CHAMBER 熱像



加熱瓦數 14 W, 自然對 流散熱

溫度分佈,百分之95以上 之面積之溫度差在1.5° C之間











CHAMBER 熱擴散現象比較









CPU 之發熱源經IHS將9mm*11mm之熱點擴散為 3.1mm*3.1mm 之發熱面, 第二階段之熱擴散為Heat Sink之底板;Socket 478及 775可用底面積 為70mm*84mm;總共擴大59倍; 若熱擴散仍然使用一般金屬作熱傳導, 因熱擴散的效率不佳,導熱板中心和板邊緣容易產生過高的溫差,導致 散熱不均勻;即使用很強的風扇,也無法將CPU內部的熱有效散掉.



工業技術研究院 Energy & Resources Laboratories

^{能源與資源研究所} Industrial Technology Research Institute 平板式 VAPOR CHAMBER 散熱元件



- 材質:無氧銅
- 尺寸:69*83*6 mm
- 熱通量: 115W/CM^{^2}
- 特性: 加貼銅鰭片後 100W加熱時,
- 風速: 11.5m/s
- Tc=54°C
- Ta=30°C
- 實測熱阻值為 0.24 °C/W





散熱能力的計算

- 不同規格之鰭片搭配不同風扇,設定鰭片 表面溫度和冷卻空氣之溫差為30℃;(以 Channel flow 強制對流的方法計算)可以 計算出不同的熱阻值.
- 在下列照片中之實施例,計算出鰭片之熱
 阻值後再加上熱超導板之熱阻值,經實際
 量測,散熱模組之合計熱阻值均非常接近.



工業技術研究院 ^{能源與資源研究所}

Industrial Tech Nolice Rease TECh Listitute Energy & cesources Law pratoiles VAPOR CHAMBER 之散熱模組



因應散熱模組使用空間 上之限制,鰭片的形式可 以做不同的變化.

左上圖例為"u"形之鰭片, 中間凹處可以安裝裸扇, 實測之熱阻值為 0.33℃/W



板式VAPOR CHAMBER 散熱模組



130W PC CPU 散熱組件 外形尺寸:70W*83L*80H 重量:450克



以HEAT PIPE為熱傳元件 散熱能力 100W左右之散執模組





- 83 x 89 x 93mm
- 96 x 82 x 120 mm
- 重量780 g
- 使用4到6支6mm直徑熱管,搭配銅,鋁鰭
 片及底板,重量均超過500克
- 若使用全銅之散熱模組,重量更高達900
 克
- 散熱模組過重及蓄熱,使主機板及CPU容 易損壞.



FANLESS的電子散熱機構

- 利用機殼及機殼鰭片自然對流散熱
- 發熱晶片及電子元件以熱超導板做第一階段熱 擴散同時將熱直接導在機殼之內壁。
- 板式VAPOR CHAMBER 可加焊導熱管將熱傳 遞到遠端機殼.
- • 自然對流的散熱能力:表面溫差 80 ℃時,
 0.01W ~ 0.1w/ cm²



板式VAPOR CHAMBER 市場用途

- 高階電腦CPU散熱系統 個人/筆記型/伺服器(針 對散熱空間不足者)
- 高階繪圖卡/硬碟/電源
 供應器
- 行車控制系統及多媒體 電子機構無風扇散熱組 件
- 無線通訊基地台散熱組
 件
- 高階遊戲機散熱模組
 PS3/XBOX/任天堂



生產Vapor Chamber 熱超導板之設備

- 工件成型模具及設備
- 電子級潔淨清洗設備
 - 真空燒結爐設備
 - 真空銀焊爐設備
 - 測漏儀器
 - 自動注料設備
 - 自動除氣,封焊設備
 - 表面抛光研磨設備
 - 鰭片鍚焊設備



HEAT FLUX (OVER 115W/CM²)VAPOR └└── CHAMBER 核心重點

- 工件材質含氧量確認·
- 多孔毛細結構,精確控制孔隙率及滲水率·
- 增加加熱點毛細結構內可產生液體薄膜之面積·
- 液體蒸發過程中氣泡通路暢通·
- 液體蒸發和蒸氣凝結為液體回流之平衡·
- 工件封焊後測漏檢查·
- 工件封焊(BRAZING OR SOLDERING)過程避免內部污染,氧化・
- 注料量要精確,預留DEGAS時之損失.
- DEGAS程序要澈底・





- > 流動阻力大
- > 傳送距離有限





























將傳統震盪型熱管微小化解決啓動不確定性問題

q = 20 W \rightarrow air cooling



液晶熱像法觀察 表面溫度分佈





PHP-1





震盪型熱管均熱片性能比較

- □ PHP-1:PHP板+銅板
- □ PHP-2: PHP板+PHP板
- □ 均熱熱阻:
 - T_c:加熱點溫度
 - T_{e1} ~ T_{e4}:均熱片四角溫度

$$R_{sp} = \frac{T_{c} - (T_{e1} + T_{e2} + T_{e3} + T_{e4})/4}{q}$$





- To investigate the influence of the heater size (concentrated heat source) with and without vapor chamber.
- Comparison of the heat spreading ability of the vapor chamber and those of copper/aluminum plate
- Three heaters with different sizes were used: 40×40 mm², 20×20 mm², and 10×10 mm²
- Input power: 50 W
- Frontal air velocity: 3, 5 and 7 m/s



Schematic of the experiment



- Schematic of heat sink attached on the base block
- Three block were used: vapor chamber, copper and aluminum plate

• Thermocouple (T-type) location on the top surface of the base block



Heat sink and the base blocks



- The attached heat sink: 21 fins.
- Fin height: 20 mm
- Fin thickness: 1 mm.



- Base blocks (from left to right: vapor chamber, copper and aluminum plate)
- Thickness: 5 mm
- Length: 86 mm
- Width: 71 mm.



Results

- Surface temperature rises and thermal resistance of each base block under different frontal air velocity
- Heater size: 40×40 mm

	U (m/s)	T _{bot} (°C)	T_{top} (°C)	R_{th} (°C/W)
Vapor	3	22.5	20.61 ± 0.34	0.041
chamber	5	17.8	15.85 ± 0.31	0.040
	7	15.1	13.06 ± 0.32	0.042
Copper	3	23.2	20.64 ± 1.10	0.055
plate	5	18.7	16.07 ± 1.10	0.054
	7	15.6	13.26 ± 1.08	0.054
Aluminum	3	24.8	20.50 ± 1.33	0.095
plate	5	20.3	15.97 ± 1.28	0.093
	7	17.6	13.25 ± 1.26	0.089





• Heater size: 20×20 mm

	U (m/s)	T _{bot} (°C)	T _{top} (°C)	R_{th} (°C/W)
Vapor	3	24.4	20.36 ± 0.36	0.088
chamber	5	19.5	15.34 ± 0.35	0.089
	7	16.9	12.71 ± 0.33	0.084
Copper	3	25.1	20.48 ± 1.23	0.100
plate	5	20.6	15.89 ± 1.22	0.100
	7	17.6	12.90 ± 1.18	0.099
Aluminum	3	30.0	20.48 ± 2.36	0.208
plate	5	25.5	15.94 ± 2.38	0.202
	7	22.5	13.24 ± 2.34	0.188





• Heater size: 10×10 mm

	U (m/s).	T _{bot} (°C)	T _{top} (°C)	R_{th} (°C/W)
Vapor	3	31.8	20.22 ± 0.40	0.251
chamber	5	26.5	15.24 ± 0.42	0.240
	7	23.4	12.48 ± 0.44	0.226
Copper	3	31.5	19.55 ± 1.56	0.270
plate	5	26.8	15.10 ± 1.50	0.250
	7	23.8	12.40 ± 1.45	0.244
Aluminum	3	35.7	20.17 ± 2.72	0.343
plate	5	30.8	15.38 ± 2.65	0.338
	7	28.1	12.76 ± 2.62	0.325


Results

 The root mean square and the maximum difference of the five measured temperatures on the top surface of the base blocks.





工業技術研究院 能源與資源研究所 Industrial Technology Research Institute Energy & Resources Laboratories

Discussion (Vapor chamber)

- When compared to pure aluminum and copper, the vapor chamber has the lowest thermal resistance due to its excellent ability of heat spreading.
- The thermal resistance (both conductive and spreading resistances) becomes larger when the heater size is reduced.
- The heater size has a significant influence to the temperature distribution of the Cu/AI plates, but has only slight effect on the temperature distribution of the vapor chamber.
- The room mean square of the top surface temperature is smallest for the vapor chamber.
- The vapor chamber has better heat spreading ability than copper/aluminum plate.







>熱管熱阻基本取決於蒸發區及冷凝區之管壁與毛細結構厚度。
 >熱管熱阻與長度沒有直接之關係。

▶毛細結構厚度增加有助於最大熱傳量的增加,但也造成熱阻值加大。
另外也會影響到蒸汽的流動。

> 孔隙度增加,液體回流阻力減少,熱傳量增加;但熱阻也增加。
 > 熱管若有後續之成形加工,參數必須以最終形狀做最佳化設計,
 以符合性能之要求。

>熱管類產品能有效降低散熱模組之熱阻,但其基本熱阻是存在的。



工業技術研究院 能源與資源研究所 Industrial Technology Research Institute Energy & Resources Laboratories





>熱管扮演傳熱的重要組件,而非散熱之用。

>熱管製作時,必須確認製程參數,是否能滿足設計之要求。
 >必須瞭解熱阻最大之地方,方能判斷熱管使用之有效性。
 >熱管應用有其極限,並非萬靈丹。

參考文獻

A. Faghri, "Heat Pipe Science and Technology", Taylor & Francis.
 G. P. Peterson, "An Introduction to Heat Pipes", John Wiley & Sons.



工業技術研究院 ^{能源與資源研究所} Industrial Technology Research Institute

Energy & Resources Laboratories

